



中華民國專利證書

發明第 I 644837 號

發明名稱：電子元件之包裝與塗佈黏劑於載帶上之並行方法
及其機構

專利權人：陳子忠

發明人：陳子忠

專利權期間：自 2018 年 12 月 21 日至 2037 年 11 月 13 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



07 年 12 月 21 日

